

TPT-Applikation: Bonden von Gold-Bändchen

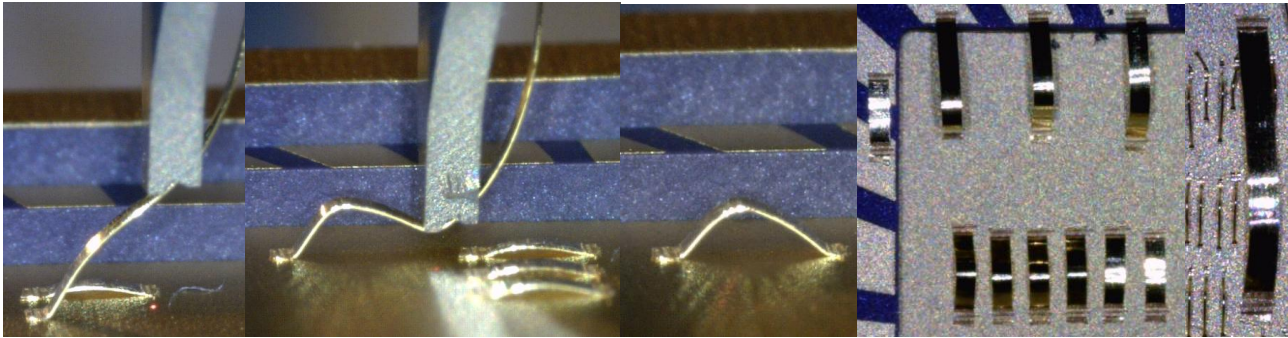
Wir stellen hier eine spezielle Bondanwendung vor – das Wedge-Bonden von Gold-Bändchen.

Anwendung:

Verbindungen mit Bändchen zeichnen sich durch einen geringen Scheinwiderstand (Impedanz) und eine gute Wärmeableitung aus. Daher finden diese oft Anwendung, z.B. in der Hochfrequenztechnik.

Material:

- 250 x 25 μ Gold-Bändchen, 10m auf 2“-Spule
- 250 x 25 μ Gold-Wedge mit Bondlänge von 100 μ
- Halbautomatischer Wedge-Bonder HB16



Bond-Prozess mit Wedge-Keil

verschiedene Bonds & Vergleich mit 25 μ -Draht

Bondprozess:

- Das Bändchen wird wie herkömmlicher Draht verwendet.
- Aufgrund der großen Bondfläche müssen die Bondparameter i.b. Ultraschall und Kraft wesentlich höher liegen als bei herkömmlichen Drähten
- Das Bändchen muss ohne Knicken & Verdrehung von der Spule in das Werkzeug gefädelt werden. Beim Einfädeln muss die rechteckige Form genau durch das Werkzeug geführt werden. Dazu das Bändchen vorher mit Schere präzise abschneiden.
- Für stabile Bonds ist die Heizung des Substrats auf 120°C nötig.



TPT Wire Bonder

Tel: 08131 / 58604

Email: info@tpt.de

Web: www.tpt.de

